

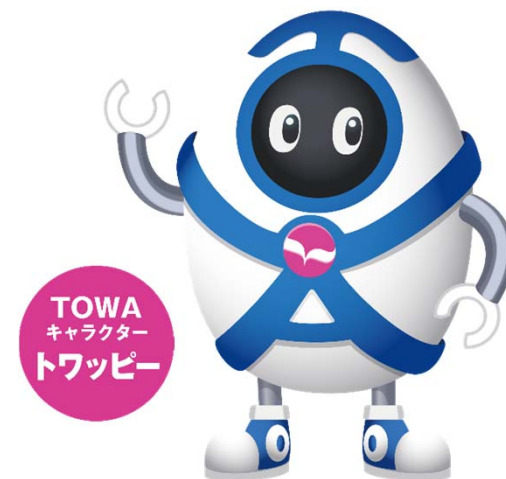


2025年3月期

第3四半期決算説明資料

2025年2月6日

[Click here for the English Ver](#)



TOWA株式会社

主な説明内容

- 1. 2025年3月期 第3四半期実績**
- 2. 2025年3月期 通期予想**
- 3. TOPICS**

主な説明内容

- 1. 2025年3月期 第3四半期実績**
2. 2025年3月期 通期予想
3. TOPICS

2025年3月期第3四半期 サマリー

受注高
371.8億円

売上高
392.5億円

営業利益
65.2億円

経常利益
70.8億円

当期純利益
51.5億円

▶ 受注高

- ・ その他アジア地域向けや次世代に向けた開発用途の受注は堅調。
- ・ 中国は経済動向やアメリカの政策動向への不透明感から減少傾向。

▶ 売上高

- ・ 中国地域での半導体内製化に向けた納入やその他アジア地域が堅調に推移。
- ・ 顧客稼働率改善や納入台数の伸びにより、TSS（トータル・ソリューション・サービス）売上が増加。

▶ 利益

- ・ 売上高の増加や製品ミックスの改善により、各段階利益ともに前年同期比で大幅増益。

2025年3月期 第3四半期 連結業績結果

(単位：億円)

	24/3期 3Q実績	25/3期 3Q実績	増減額	前年比
売上高	320.3	392.5	+ 72.2	+ 22.6%
営業利益	40.7	65.2	+ 24.5	+ 60.0%
営業利益率	12.7%	16.6%	—	+ 3.9pt
経常利益	43.1	70.8	+ 27.6	+ 64.0%
当期純利益	31.1	51.5	+ 20.4	+ 65.5%

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

2025年3月期 第3四半期セグメント別売上高

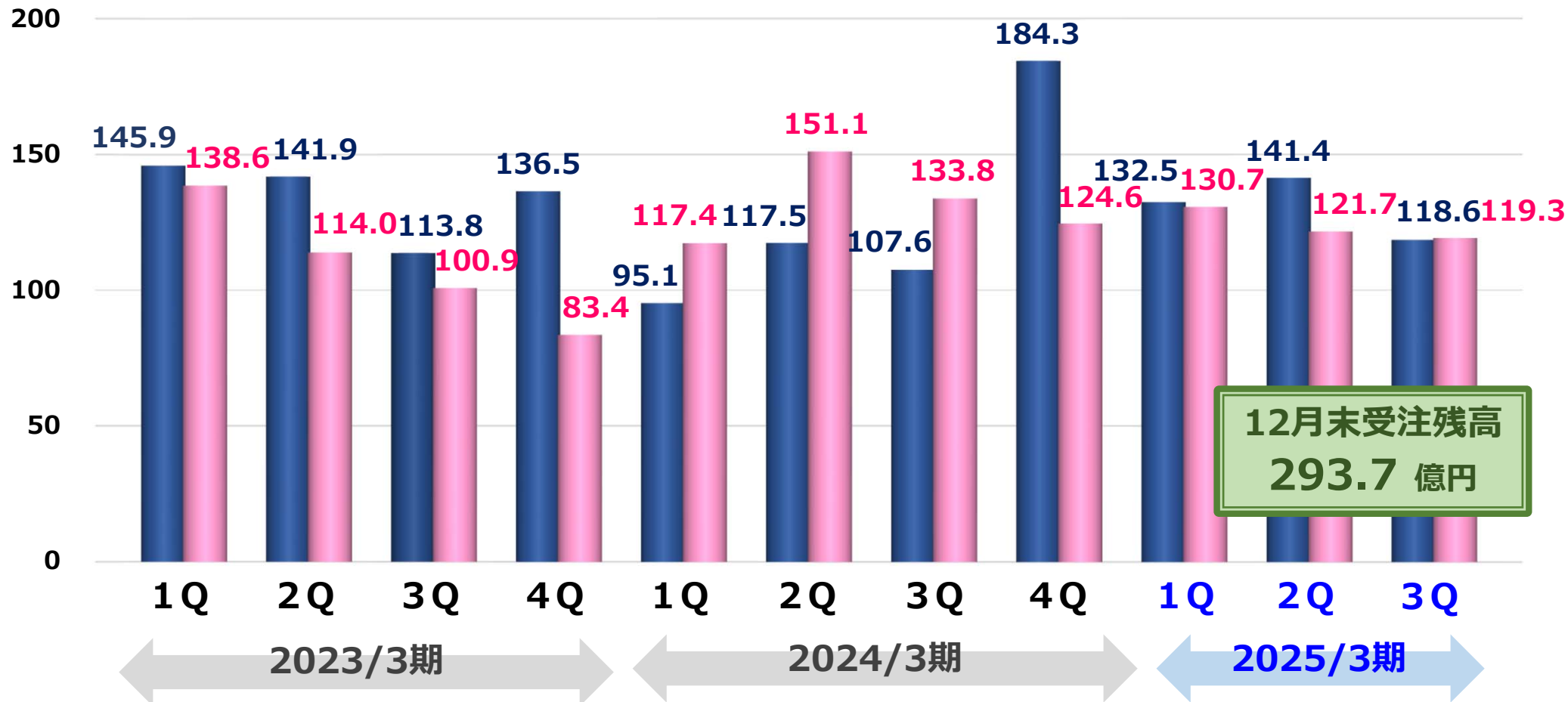
(単位：億円)

	24/3期 3Q実績	25/3期 3Q実績	増減額	前年比
売上高	320.3	392.5	+ 72.2	+ 22.6%
半導体事業	236.1	292.7	+ 56.6	+ 24.0%
化成製品事業	16.2	17.3	+ 1.1	+ 6.5%
新事業	50.4	68.4	+ 18.0	+ 35.9%
レーザ事業	17.6	14.1	▲ 3.5	▲ 19.9%

受注・売上高の推移

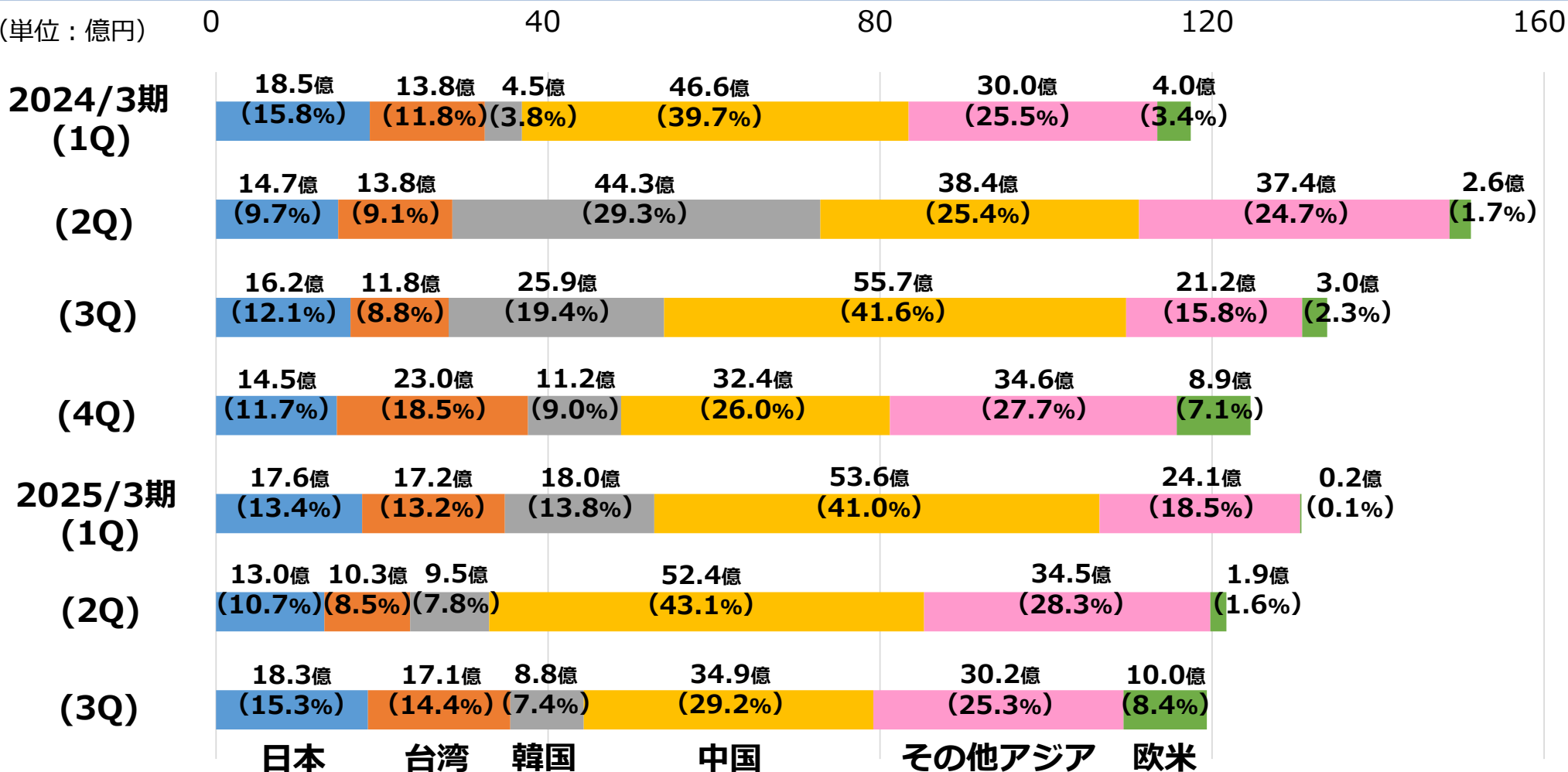
(単位：億円)

■ 売上高 ■ 受注高



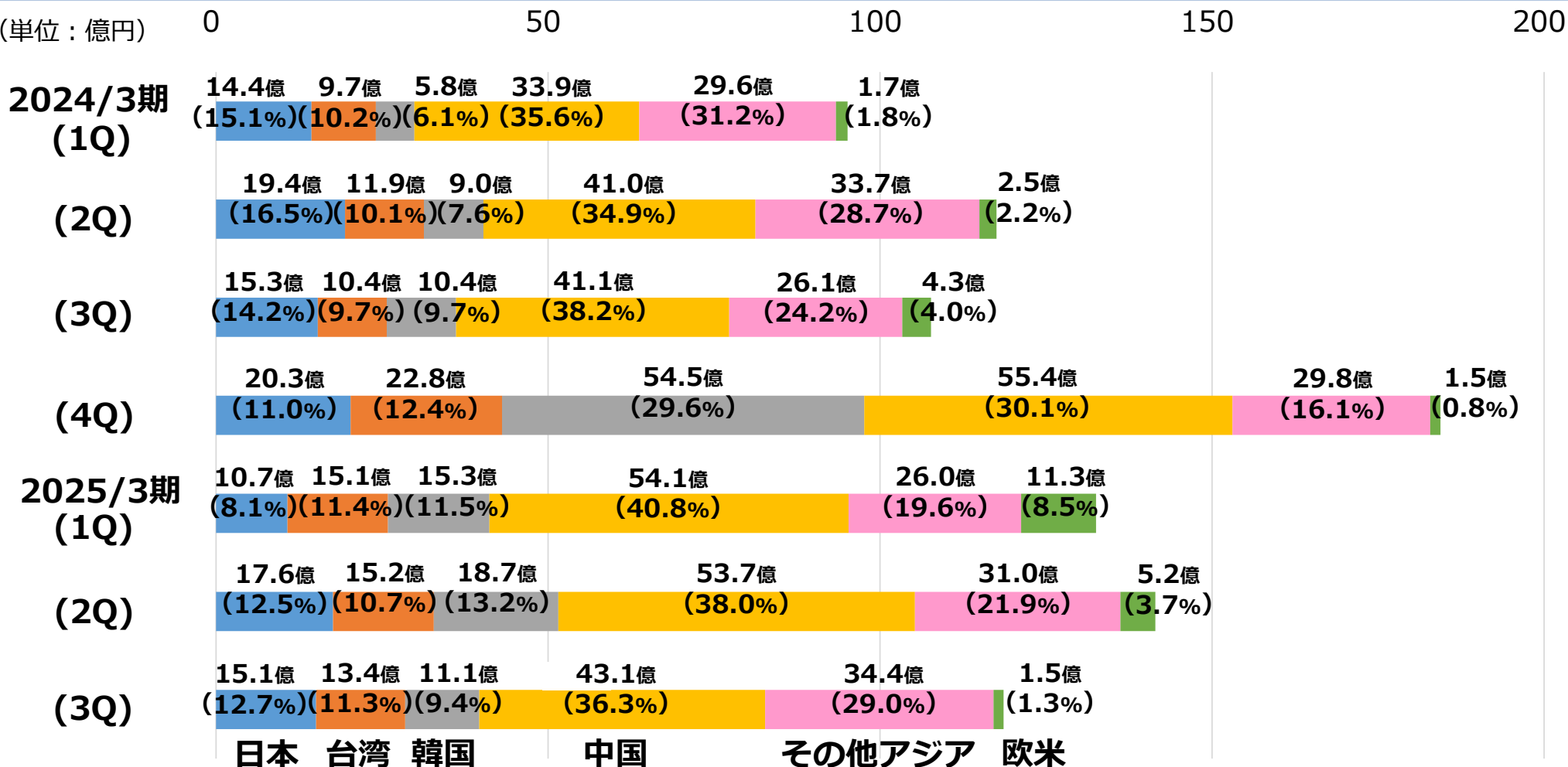
地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）

（単位：億円）



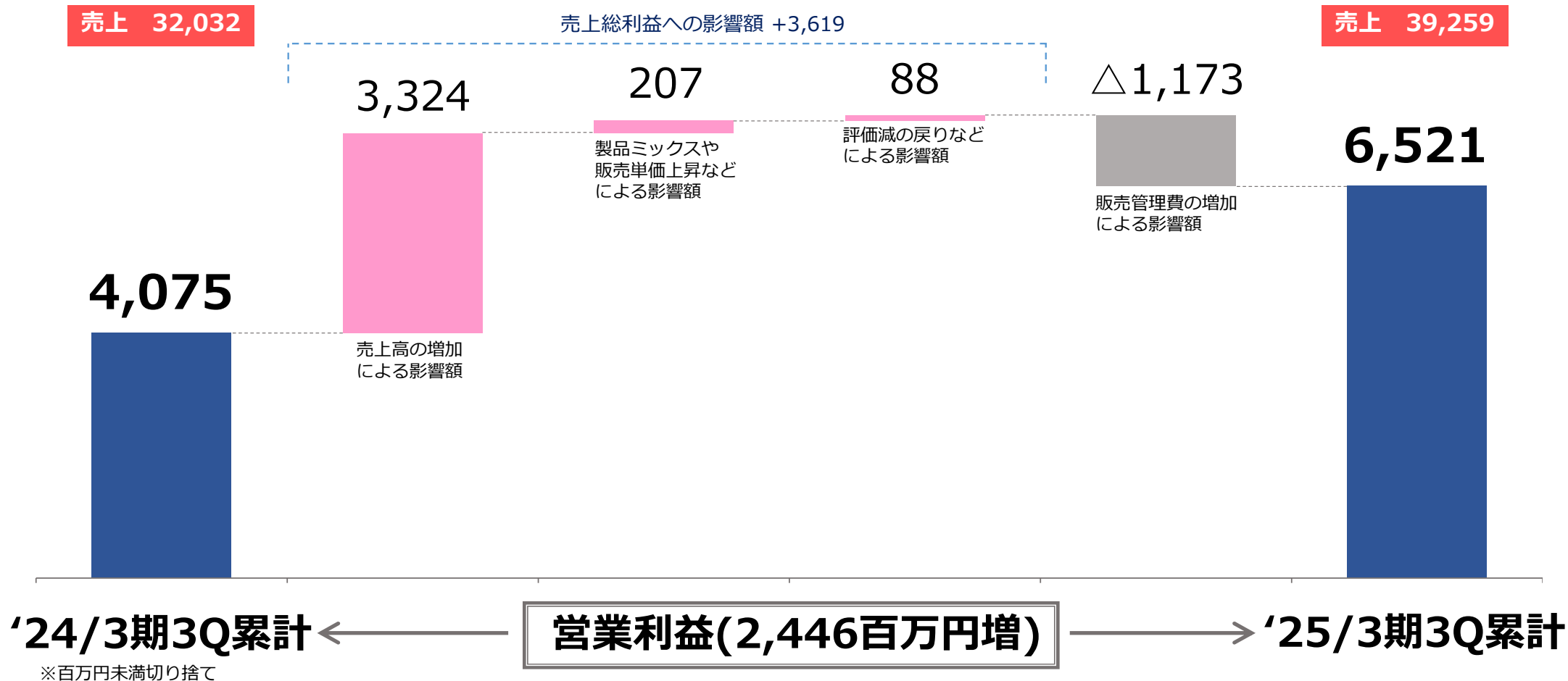
地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）

（単位：億円）



2025年3月期3Q累計 連結営業利益 増減要因分析（対前年同期比）

（単位：百万円）



主な説明内容

1. 2025年3月期 第3四半期実績
2. 2025年3月期 通期予想
3. TOPICS

2025年3月期 通期 連結業績予想

※期初予想から変更あり

(単位：億円)

	24/3期 通期実績	25/3期 予想			増減額	前期比
		3Q累計実績	4Q予想	通期		
売上高	504.7	392.5	147.4	540.0	+ 35.3	+ 7.0%
営業利益	86.6	65.2	26.8	92.0	+ 5.4	+ 6.2%
営業利益率	17.2%	16.6%	18.2%	17.0%	—	▲ 0.2pt
経常利益	90.7	70.8	26.8	97.6	+ 6.8	+ 7.5%
当期純利益	64.4	51.5	27.2	78.7	+ 14.3	+ 22.1%

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

2025年3月期 セグメント別売上予想

※前回予想から変更あり

(単位：億円)

	24/3期 通期実績	25/3期 予想			増減額	前期比
		3Q累計実績	4Q予想	通期		
売上高	504.7	392.5	147.4	540.0	+ 35.3	+ 7.0%
半導体事業	383.2	292.7	106.3	399.0	+ 15.8	+ 4.1%
化成品事業	21.5	17.3	5.5	22.8	+ 1.3	+ 6.0%
新事業	75.8	68.4	27.2	95.6	+ 19.8	+ 26.2%
レーザ事業	24.2	14.1	8.5	22.6	▲ 1.6	▲ 6.6%

今後の市場見通し

今後の市場見通し

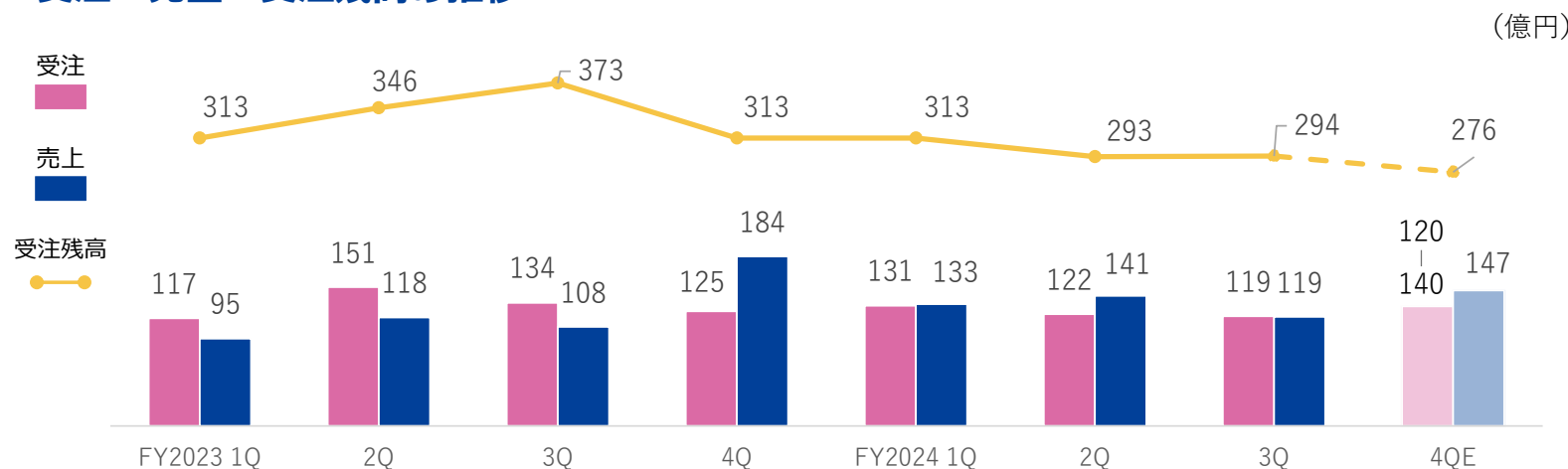
- 売上高および利益については民生品向け半導体やメモリ半導体の投資回復が想定以上に遅れていることに加え、中国地域における顧客の投資意欲の減退から下方修正。
- 4Qの受注高については、2Q終了時点の予想（120億円～140億円）を据え置き。短期的な市況改善は期待出来ないものの、先端パッケージや開発向けは堅調に推移する見込み。

損益予想

(2025.02.06 修正)

売上高	540億円
営業利益	92億円
経常利益	97.6億円
当期利益	78.7億円

受注・売上・受注残高の推移



主な説明内容

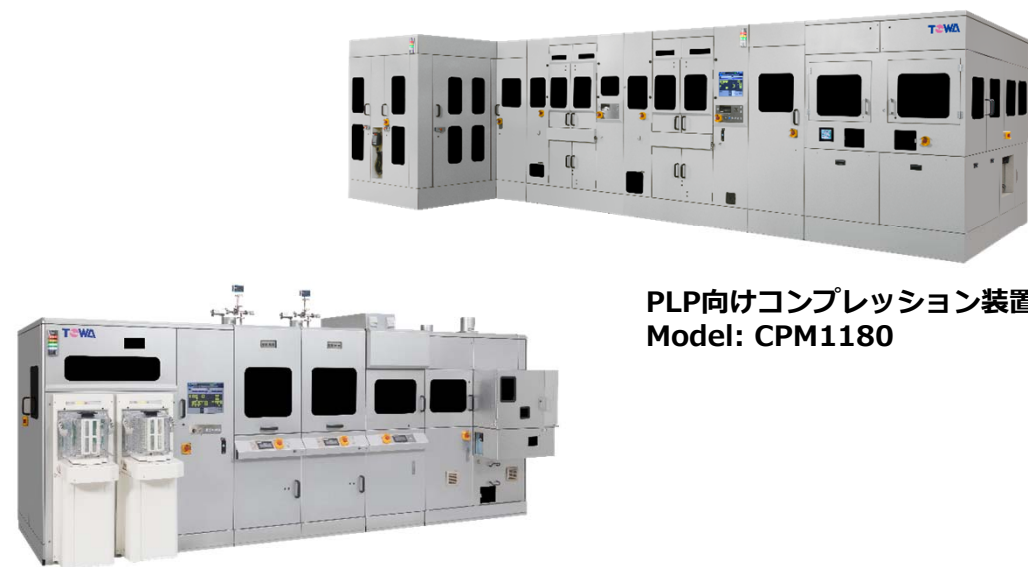
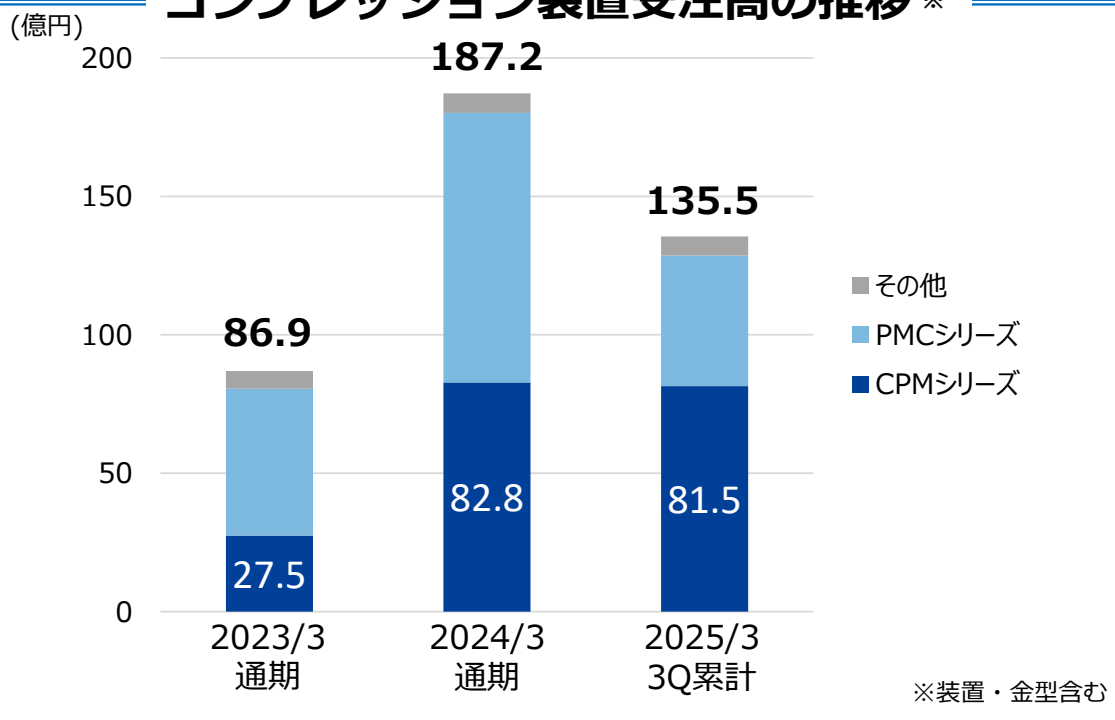
1. 2025年3月期 第3四半期実績
2. 2025年3月期 通期予想
3. **TOPICS**

コンプレッション装置

先端半導体や次世代製品開発向け装置の需要は堅調

- 生成AI関連向けや開発用途向けにコンプレッション装置の需要が堅調。
WLP・PLP向けのCPMシリーズの受注割合が増加。

コンプレッション装置受注高の推移 ※



PLP向けコンプレッション装置
Model: CPM1180

WLP向けコンプレッション装置
Model: CPM1080

T O W A ビ ジ ョ ン 2 0 3 2

「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

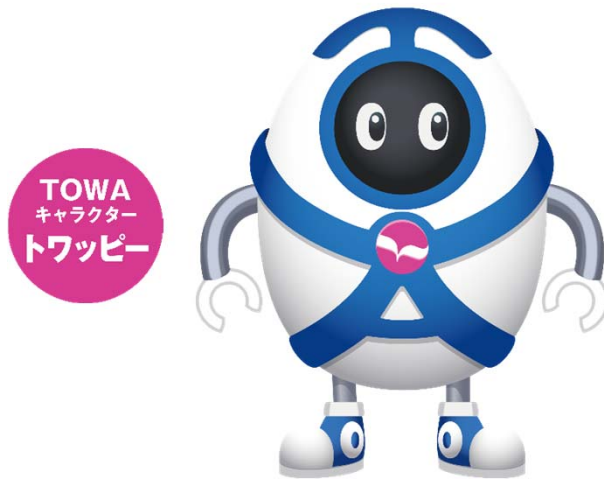
〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。

参考資料



会社概要



トワッピーのプロフィール

- ① 名前：「トワッピー」
- ② 名前の由来：
TOWAから世界にハッピーを届ける。
- ③ 好きな言葉：「チャレンジ！」

会社名

TOWA株式会社

事業内容

半導体事業、新事業、化成品事業、
レーザ加工装置事業

所在地

京都市南区上烏羽上調子町 5 番地

設立

1979年 4 月

代表取締役社長

岡田 博和

従業員数

2,085名（2024年12月末時点/連結）

資本金

89億円

証券コード

6315

事業内容

新事業

- ・ TSS
(トータルソリューションサービス)
- ・ 精密加工用工具、受託加工
- ・ 微細加工
- ・ コーティング



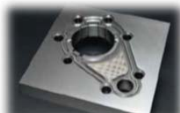
改造・修理
予防保全



微細加工技術



工具 (エンドミル)



受託加工

化成品事業

- ・ ファインプラスチック成形品
- ・ 医療機器



点滴用部品



注射器用部品

レーザ加工装置事業

- ・ レーザトリマ
- ・ ウェハーマーカ
- ・ レーザ溶接機



レーザトリミング装置
Model SL432R



ウェハーマーキング装置
Model SL473GS3

半導体事業

- ・ 半導体製造用精密金型
- ・ 半導体製造用モールドング装置
- ・ 半導体製造用シンギュレーション装置



トランスファ金型



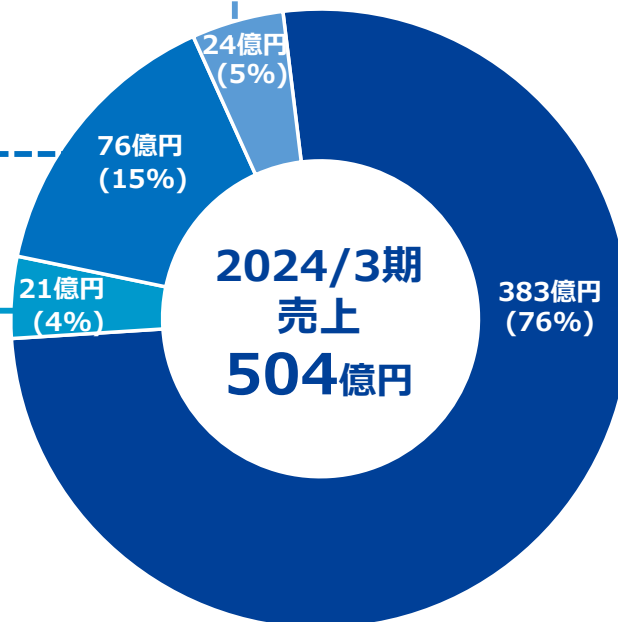
モールドング装置
Model PMC2030-D



コンプレッション金型

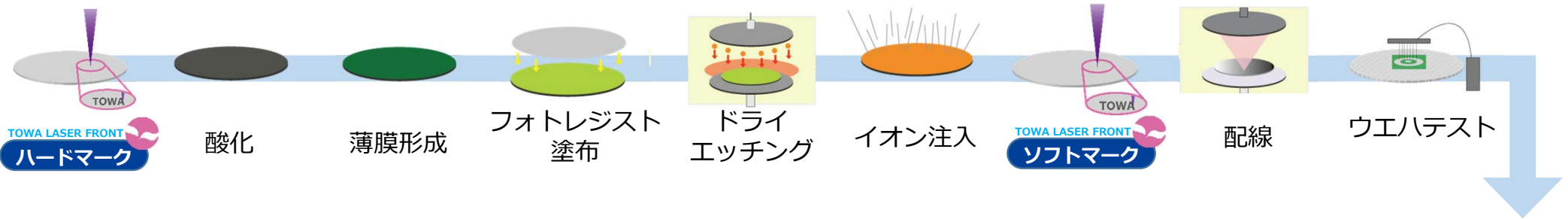


モールドング装置
Model CPM1080



半導体が出来るまで

前工程

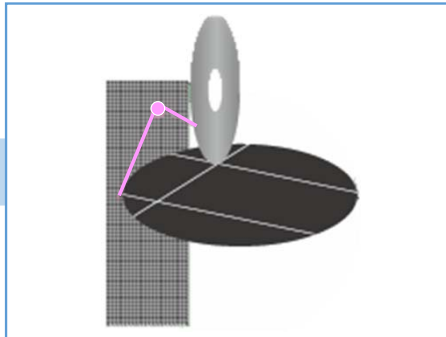


TOWA

製品検査や
信頼性試験を
経て・・・

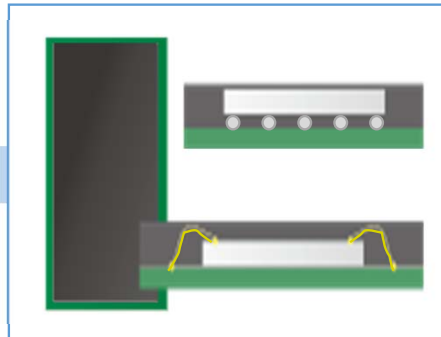
**半導体
完成！**

シンギュレーション



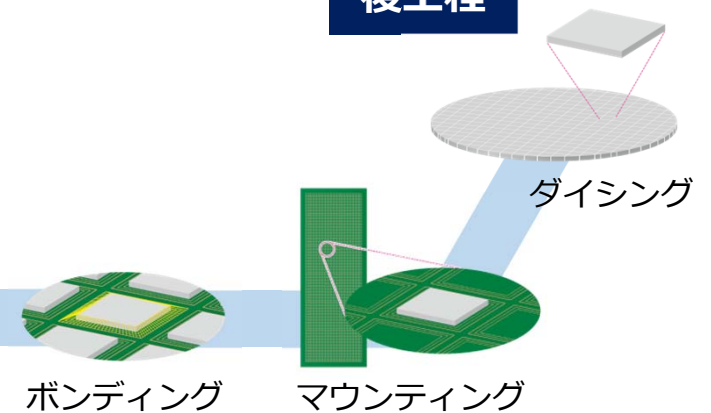
フレームから個々の製品を
切り離します。

モールドイング

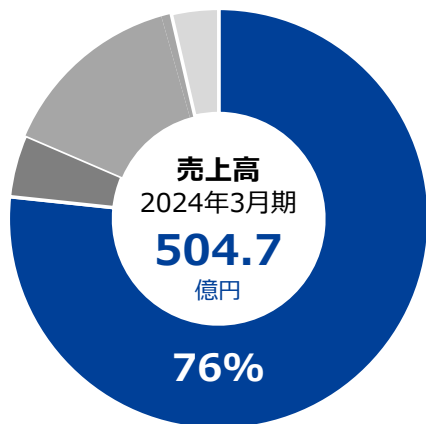


チップを樹脂で封止します。

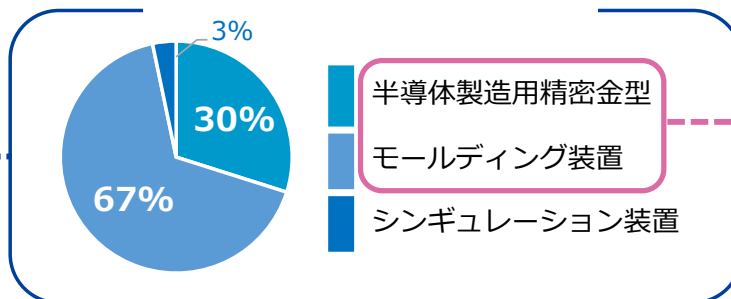
後工程



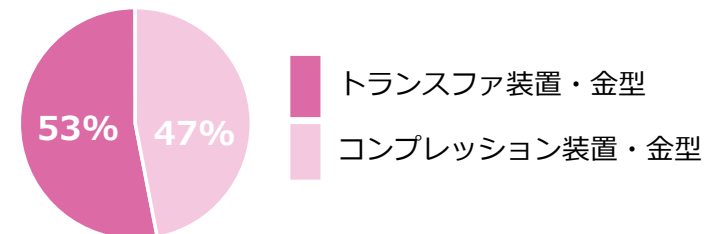
半導体事業



半導体事業 383.2億円



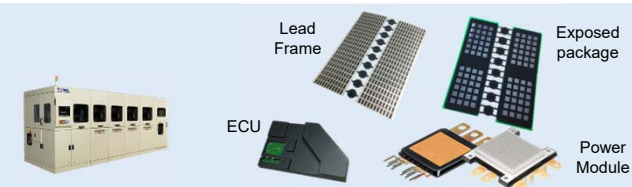
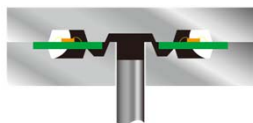
モールドイング装置・金型 369.6億円



モールドイング

トランスファ成形

ポット内で溶融した樹脂を
キャビティに充填し
硬化させる成形手法

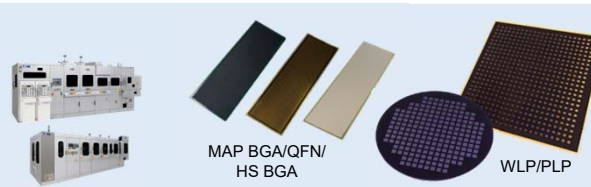


トランスファ装置

Work size (Max.): 100×300mm

コンプレッション成形

金型に直接樹脂を入れ、
溶融した後にワークを
浸し入れる成形手法

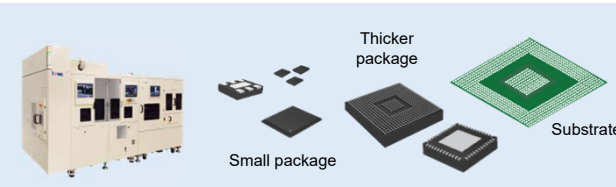


コンプレッション装置

Work size (Max.): 660×620mm

シンギュレーション

樹脂で封止された製品を
個片化・収納する工程



シンギュレーション装置

Package size (Min.): 1×1 mm

新事業

「新たな市場」創造と事業化へのチャレンジ

TSS事業

(トータルソリューションサービス)

当社半導体製造装置のアフターサービスや改造・修理、中古機の販売までトータルで提案



世界のモールドプロセスをTOWAに！！

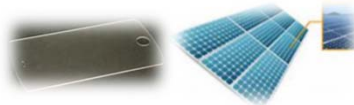
- LEプログラム
(ライフエクステンション)
- 中古機販売
- 予防保全 (年間契約)
- 部品供給
- トレーニングセンター

コーティング

TOWAオリジナルの金型表面処理技術を医療や家庭用品等に応用展開



打錠分野への普及率向上



ガラス製品への普及率向上

ナノテク

超精密金型加工で培った超精密・微細加工技術を医療、自動車分野等に応用展開



細胞培養分野における商品開発



HUD(ヘッドアップディスプレイ)用レンズの開発



空中映像素子レンズの開発

ツーリング

金型製造メーカーのノウハウが蓄積された自社開発の工具を販売



CBN・超硬エンドミル



受託加工



3Dプリンタと自社製工具の融合

化成品事業

会社名 株式会社バンディック

代表取締役社長 寺内 利浩

事業内容 医療用プラスチック成形品の製造
医療機器の組立

従業員数 82名（2024年12月末時点）

所在地 山梨県韮崎市龍岡町下條南割596の146

設立 1983年11月18日

主な製品

医療用プラスチック成形品



超精密金型技術と独自技術による プラスチック成形プロセス



クリーンルーム内で組立、生産

レーザ加工装置事業

会社名

TOWAレーザーフロント株式会社

代表取締役社長

早坂 昇

事業内容

レーザ及びレーザ加工装置の
開発・設計・製造・販売・保守

従業員数

106名（2024年12月末時点）

所在地

神奈川県相模原市中央区下九沢1120番地

株式取得日

2018年8月1日

主な製品

レーザトリマ



ウェハマーカ

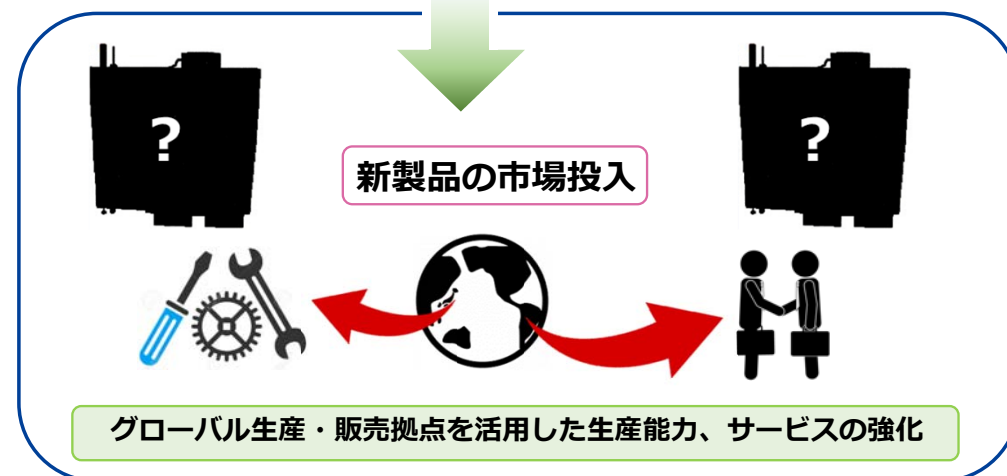


レーザ溶接機



レーザ関連技術と半導体製造の
後工程技術を融合し、新たな市場へ

TOWA X LASERFRONT



生産拠点

●TOWA

●グループ会社



韓国

●TOWA韓国株式会社

»半導体製造装置、精密金型、部品の製造



●TOWAファイン株式会社

»ブレードの製造



中国

●TOWA半導体設備(蘇州)有限公司

»半導体製造装置、精密金型の製造



●東和半導体設備(南通)有限公司

»半導体製造装置、精密金型の製造



マレーシア

●TOWAM Sdn. Bhd.

»半導体製造装置の製造



●TOWA TOOL Sdn. Bhd.

»半導体製造用金型の製造



京都

●本社・工場(京都市)

»半導体製造装置、精密金型の開発・製造



京都

●京都東事業所(宇治田原町)

»半導体製造用金型の製造



佐賀県(鳥栖市)

●九州事業所

»半導体製造用金型の製造



日本

山梨県(韮崎市)

●株式会社バンディック

»ファインプラスチック成形品の製造

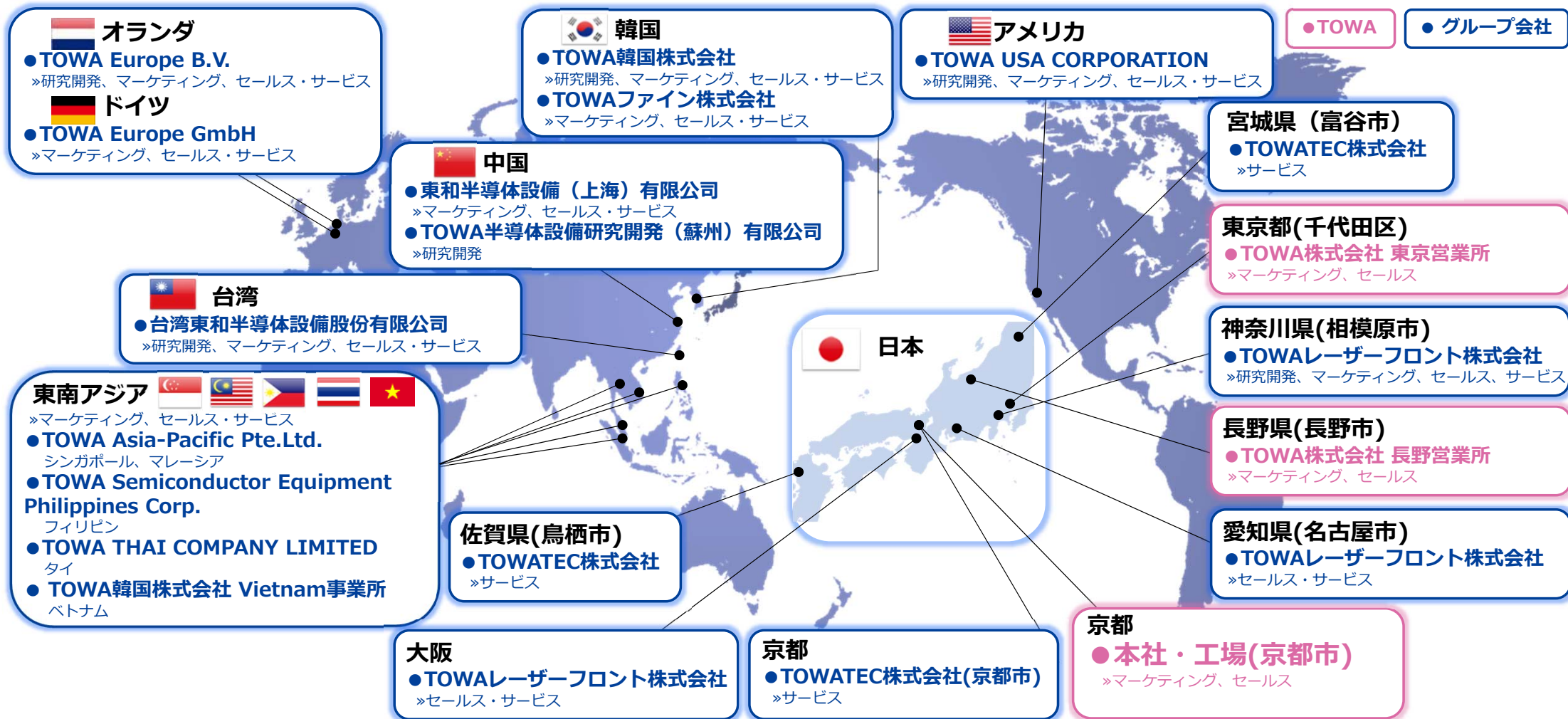


神奈川県(相模原市)

●TOWAレーザーフロント株式会社

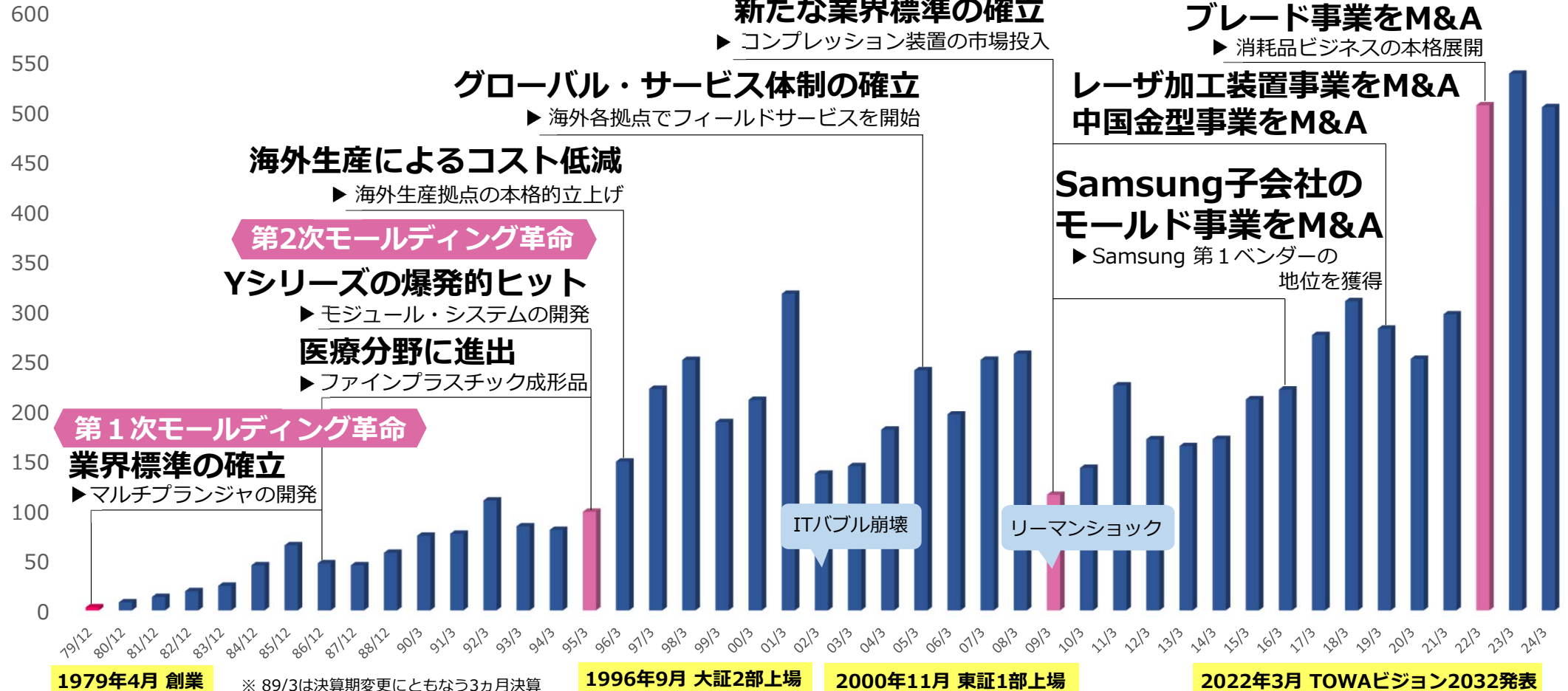
»レーザー及びレーザー加工装置の開発、製造

販売・サービス拠点



TOWAの歩み

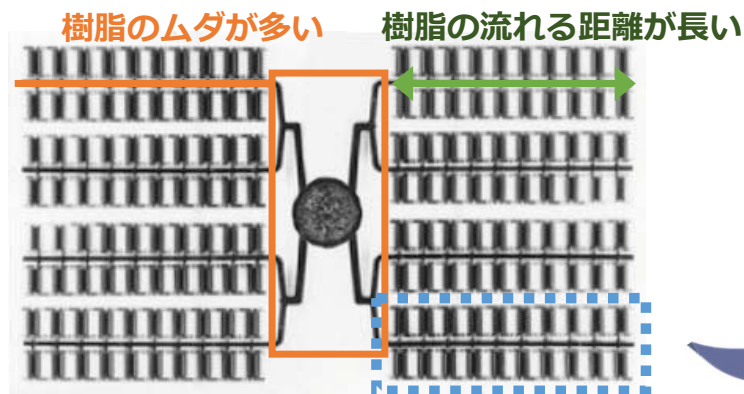
(億円)



第1次モールドディング革命(1979年)

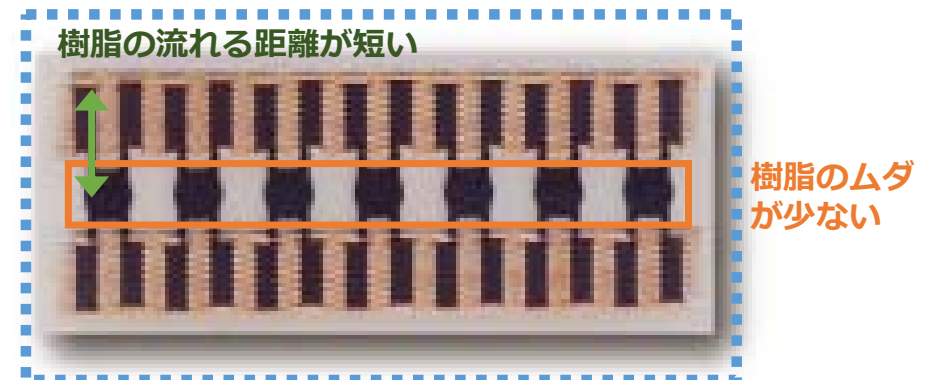
コンベンショナルモールド

手のひらサイズの樹脂を一カ所から注入し、**手動**で成形。樹脂の流れる**距離が長く**成形品質に**バラツキ**が出来、**樹脂のムダが多い**。



マルチプランジャモールド

指先サイズの樹脂を複数カ所から注入し、**自動**で成形。樹脂の流れる**距離が短く**成形品質が**向上**し、**樹脂のムダが少ない**。



第2次モールドディング革命(1995年)

モジュールシステム (Yシリーズ)

モジュールシステム以前のモールドディング装置は・・・

- ・ 一品一様であり、生産する**製品毎に装置を買い替え**
- ・ 生産量に応じて**複数の装置を保有**する必要がある



モジュールシステムにより**プレス**の増減が可能に!!

- ・ Yシリーズだけで**様々な製品の生産が可能**
- ・ 生産量に応じて**追加で設備投資が可能**

後工程をIDMから組立専門企業が請け負う時代のニーズに合致!!

世界に誇る半導体モールドディング装置のベストセラー



第3次モールドディング革命(2009年)

コンプレッション装置

TOWA独自のコンプレッション（圧縮）成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能に!!

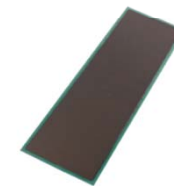
特許や技術的難易度の高さから2009年のリリース以来、現在まで**他社の追随なし。**

特 徴

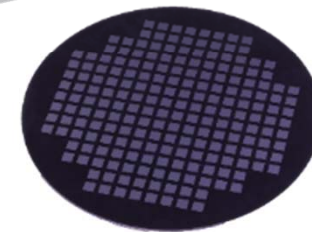
- ・樹脂使用効率**100%**（**CO2排出量約70%削減**）
- ・樹脂流動のない圧縮成形（**不良品が少ない**）
- ・メモリや5G向けなどの**最先端製品**に最適
- ・顆粒/液状樹脂の両方に対応
- ・パネルサイズ、ウェハーサイズに対応



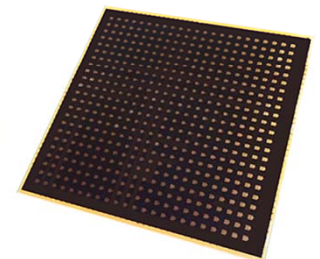
コンプレッション装置
Model PMC2030-D



基板サイズ
100×300mm



ウェハーサイズ
φ300mm



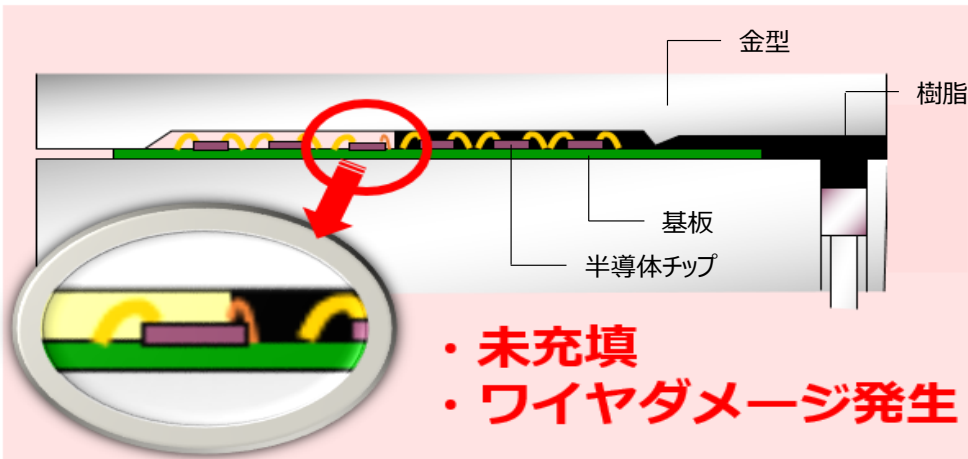
パネルサイズ
600mm×600mm

半導体パッケージへのソリューション

トランスファ成形

注入方式

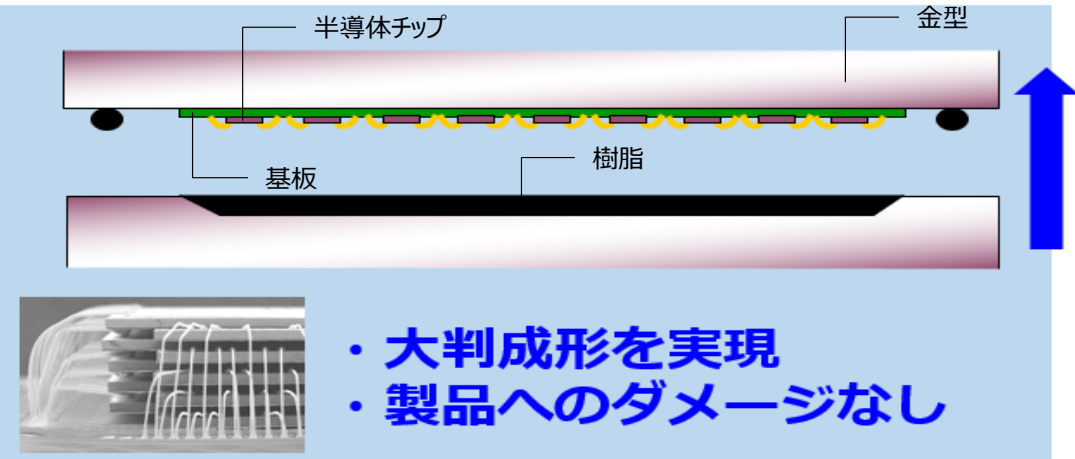
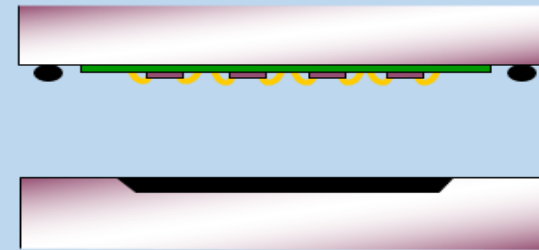
樹脂流動
有



圧縮方式

コンプレッション成形

樹脂流動
無



半導体製造装置ラインナップ

～ Compression Mold ～

コンプレッション装置

Model CPM 1180



Work max size: 660 × 620mm

コンプレッション装置

Model CPM 1080



Work max size: φ300mm、320x320mm

コンプレッション装置

Model PMC 2030-D



Work max size: 100x300mm

～ Transfer Mold ～

トランスファ装置

Model YPM 1180



Work max size: 100x300mm

トランスファ装置

Model YPM1250-EPQ



Work max size: □150mm、100x300mm

～ Singulation ～

シンギュレーション装置

Model FMS 4040



Work max size: 100x300mm